

POST CARD

STAMP

TOKYO DENTAL SHOW 2009

世界最大手デンツプライ・グループの持つ革新的先端技術が皆様をお迎えいたします。

弊社ブースにご来場の際は、下記の各欄にご記入の上、このハガキをご持参いただきますよう、お願い致します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

東京デンタルショー 2009

テーマ：『口腔から全身の健康を科学する』

日 時：2009年11月7日(土)10:00~19:00 11月8日(日)09:00~18:00

場 所：東京ビッグサイト(東京国際展示場)東京都江東区有明 3-21-1

ご氏名

ご施設名

ご専門

(下記のいずれかに をおつけください)

一般 ・ 小児 ・ 口腔外科 ・ 矯正 ・ 技工 ・ 衛生

出展案内

詳しくは
裏面を
ご覧下さい



デンツプライ三金株式会社

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10 偕成ビル TEL. 03-5114-1001 (代表)

東京デンタルショー2009 ご案内

デンツプライ三金ブース No.1-57

■ 東京デンタルショー2009 概要

テーマ 『口腔から全身の健康を科学する』

日 時 2009年
11月7日(土) 10:00~19:00
11月8日(日) 9:00~18:00

会 場 東京ビッグサイト(東京国際展示場)
〒135-0063 東京都江東区有明3-21-1

■ デンツプライ三金 出展社セミナー

11/7(土) 17:00~18:00

会 場：セミナーA会場
テーマ：長期安定のためのインプラント治療
講演者：日本大学松戸歯学部口腔顎顔面
インプラント学講座 准教授 口腔インプラント科長
加藤 仁夫 先生

11/8(日) 15:30~16:30

会 場：セミナーC会場
テーマ：補綴技工に応じた「セルコンCAD/CAMシステム」の進化
講演者：有限会社 協和デンタルラボラトリー 代表取締役
日技認定技工士
日本大学歯学部付属歯科技工専門学校兼任講師
木村 健二 先生

弊社ブースにご来場の際には、このハガキをご持参ください。

新製品



セルコンアイ・セルコンアートII

メタルボンドおよびジルコニアのコーピング製作が可能となったCADシステム



ISUS

テーラーメイドによる補綴重視のインプラント ストラクチャー製作システム



ルシトーンFRS

主成分トログミドCX7323は米国薬局方クラス を取得した、優れた安全性を有するノンクラスプ義歯床用弾性レジン



アクアジルウルトラ B4 & digit

シリコン印象材アクアジルウルトラの能力を最大限に引き出す“B4”と、シリンジ感覚で簡単に使えるデリバリーシステム“digit”